



平成 28 年 11 月 7 日

各 位

会社名 株式会社テラプローブ
代表者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

連結子会社の増資に関するお知らせ

当社の連結子会社である TeraPower Technology Inc. は、本日開催の董事会において、下記のとおり、増資を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. TeraPower Technology Inc. の概要

- (1) 商 号 TeraPower Technology Inc.
- (2) 代 表 者 C. H. Lin
- (3) 所 在 地 No. 26, Wenhua Rd., Hsinchu Industrial Park. Hukou, Hsinchu 303, Taiwan
- (4) 資 本 金 NT\$1,000,500,000
- (5) 事 業 内 容 半導体ウエハテスト受託
- (6) 設 立 年 月 日 平成 20 年 8 月
- (7) 増資前出資比率 当社 51.0%
Powertech Technology Inc. 49.0%

2. TeraPower Technology Inc. の増資の内容

- (1) 増 資 金 額 NT\$600,000,000
当社出資額 NT\$306,000,000 (約 10 億円) ※
- (2) 増資後の資本金 NT\$1,600,500,000
- (3) 払 込 期 日 平成 28 年 12 月 (予定)
- (4) 増資後出資比率 当社 51.0%
Powertech Technology Inc. 49.0%

※増資金額の円換算額につきましては、現在の為替相場により換算しております。

増資時点の為替相場により、円換算額は変更されることが予想されます。

3. 増資の目的

TeraPower Technology Inc. は、当グループの台湾拠点として、半導体ウエハテスト受託を行ってまいりました。更なる生産能力の増強に対応するため、増資を実施いたします。

4. 業績に与える影響について

今回の増資が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以上